

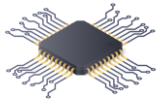


About  
Test & System Package 총괄(DS부문)

# Test & System Package 총괄

## 사업부 소개

### Test & System Package 총괄



메모리, S.LSI 반도체 Package의 개발부터 생산, TEST, 제품출하까지 **전 과정을 총괄** 하는 사업부



Digital & Analog Logic 설계



유/무기 신소재 개발



Package Design



품질보증/ 수율 개선



Big Data, AI기반 분석 Test Firmware/OS 개발



설비 개발 및 자동화 시스템 운영



Electrical/Thermal /Mechanical Simulation

## 사업부 비전

“ **첨단 Package 개발/양산을 통한 반도체 가치 극대화** ”

## 주요 사업장

### 화성 캠퍼스

기반기술 연구 및 Simulation

### 천안 캠퍼스

TSV, HBM 등 신기술 개발 및 양산

### 온양 캠퍼스

메모리 (DRAM, NAND FLASH), S.LSI, SSD Module 생산

# TSP총괄 직무 소개

## Package개발 직무

반도체 Packaging 기술/소재/공정을 연구하고  
첨단 반도체 Package 제품을 개발하는 직무

- **Package Process Integration**
  - 메모리, S.LSI 및 Foundry 사업부 向 Package 제품개발
  - Package 단위공정 및 요소기술과 Organic, Inorganic Material 개발
- **Package Design**
  - Device와 Set Board 간 신호, 전력 전송을 위한 Package Design
  - Package Electrical/Thermal/Mechanical 최적화 Simulation
- **RFA (Reliability & Failure Analysis)**
  - Package의 신뢰성 확보를 위한 소재와 구조에 대한 연구
  - 신뢰성 평가 기술, 가속수명시험 개발 및 기준 제정
- **공정 기술**
  - Package 단위 공정 생산성 향상, 품질 문제 분석 및 해결
  - 신공정 기술 발굴, 적용 및 공정 표준화, 원가 절감 및 Process 효율화
- **양산품질 보증 / Yield 개선**
  - 공정 변경점 및 산포 관리를 통해 품질 위험요소를 관리/개선하여 품질 향상

## 평가 및 분석 직무

반도체의 물리적/전기적 동작 특성을 평가하여  
불량을 검출하고 Test 설비/프로그램/인프라 최적화  
를 통해 생산성을 향상시키는 직무

- **회로 설계 (SI/PI) 및 Digital & Analog Logic 설계**
  - 신제품 TEST Infra 개발, Tester 생산성/성능 향상, Analog ASIC 소자 개발
  - High Speed Signal 전송 기법 연구 개발
- **Test관련 infra(Tool) modeling 및 mechanical 분석**
  - Test Contact에 대한 modeling 및 Mechanical 분석기술로 구조 개선
  - 기구/구조 Simulation으로 Test 구조 최적화, Test Infra 공차 해석 및 개선
- **Solution 제품 Test Algorithm 및 Tool 개발**
  - Customer의 요구에 부합하는 품질을 보장하는 Test Algorithm 개발
  - Firmware, Test OS, 양산 UI, SW 등 개발
- **제품 Test 양산성 확보**
  - 제품 (AP, RF, PMIC, NFC, ASIC 등)의 Package Test Coverage 향상

## 설비 기술

최고 품질의 반도체 제품 생산을 위해 설비를 개조/  
개선하고 미래 반도체 제조 인프라를 구축하는 직무

- **첨단 반도체 설비 관리**
  - 반도체 생산유지를 위한 설비 관리 (고장조치, Part 교체, 불합리 개선)
  - 설비 data Trend 분석을 통한 개선 활동 및 설비관리 Tool 개발
- **설비 개조/개선**
  - 반도체 생산성, 품질 향상을 위한 반도체 설비 개조/개선, 시스템 개발 및 작업 환경 solution 제시
- **제조 인프라 개선**
  - 스마트 제조환경 구축을 위한 물류 자동화, 운영 시스템 설계
  - Big Data 활용한 실시간 제조현장 모니터링 설계, 제조 플랫폼 기술 개발  
→ Thermal Control, Thermal Uniformity 향상